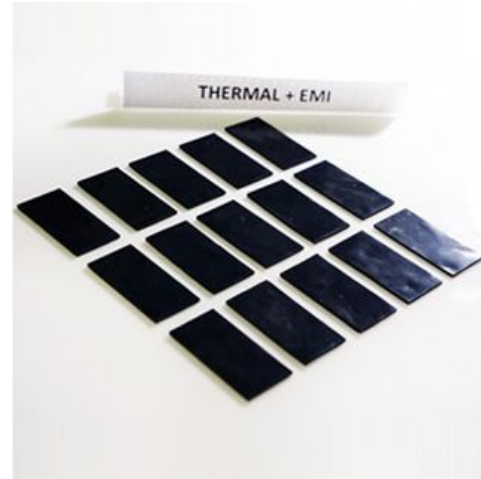


## 导热吸波硅胶软垫片 XK-J18

同时具有热对策与电磁波对策,双功能集一身的 XK-J18, 可以在有限空间与时间解决问题,简化机构设计降低成本,同时间软质硅胶基底可以降低内部应力与容许公差,始终端产品有更好可靠度设计..



规格	unit	XK-J18	Method
颜色 Color		Dark Gray	visual
厚度 Thickness	mm	0.5~3.0	ASTM D374
比重 Specific Gravity	g/cm <sup>3</sup>	4	ASTM D792
硬度 Hardness	Asker C	18	JIS K7312
	Shore 00	45	ASTM D2240
热阻抗 Thermal impedance@0.5mm	°Cin <sup>2</sup> /W	0.67	ASTM D5470
导热系数 Thermal Conductivity	W/mK	1.8	HOT DISK
1Mhz 渗透 1Mhz Permeability	1	10	1Mhz
1Ghz 渗透 1Ghz Permeability	1	2	1Ghz
抗张强度 Tensile strength	psi	40	ASTM D149
伸长率 Elongation	%	30	ASTM D149
硅氧烷挥发 Siloxane Volatiles D4~D20	%	0.01	GC-FID
阻燃性 Flammability	UL94	V-0	UL94